



AI需求强劲 PCB产业链景气度扩散

开栏语

A股上市公司一季报近日陆续披露，中国经济发展的热力图正渐次分明。

观势，更要明势。热气腾腾的数据背后，究竟哪些产业景气率先回升？业绩后劲因何在？发展势头如何巩固？尚有哪些薄弱环节？即日起，上海证券报开设“一季看全年”专栏，通过分析研判上市公司一季报（含业绩预告），深入采访上市公司及行业人士，及时了解相关产业经营情况和未来生产计划等，挖掘数据背后的经济活力、成长动能，把脉景气度背后的产业升级、创新提质，从微观企业切口感受宏观经济的蓬勃动力。

记者 杨子晏

最近一周，一批PCB（印制电路板）产业链公司披露了2026年一季度业绩大增的公告。这折射出，在AI需求强劲增长的背景下，该产业链上下游的景气度正由PCB制造环节向上游材料、关键设备等领域扩散。

“真是供不应求。”有PCB龙头企业说。多家接受上海证券报记者采访的行业高管认为，从一季度订单、价格及产能变化可预见，这股火爆劲有望一直延续到年底，甚至明年。同时，企业的扩产步伐也在加快。“但越到后面，行业就会分化。未来，高端产能与技术能力将成为企业竞争的关键分水岭”。

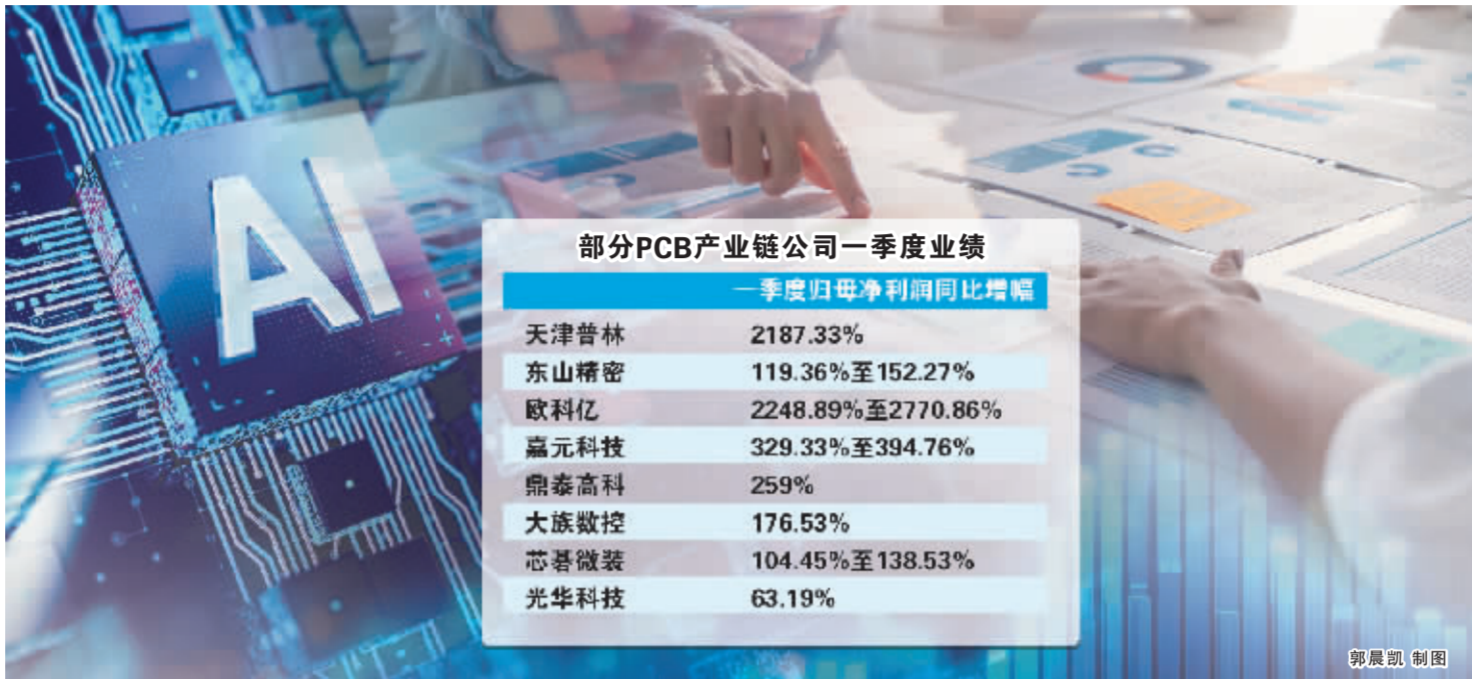
业绩大增 PCB产业链科技含量增加

PCB是承载并连接电子元器件的核心载体，业内称为“电子产品之母”。过去，其主要应用于手机、电脑等消费电子领域。如今，随着AI发展带动算力需求爆发，PCB正成为服务器、数据中心及高速通信设备等算力基础设施的关键硬件。

一位不愿具名的投资人向记者表示，PCB行业增长逻辑正由传统消费电子驱动，转向算力驱动，“PCB行业从过去制造业属性，逐渐转变为‘科技+制造业’属性”。

这样的转变，已经体现在产业链的一季度业绩上——以前，一季度是PCB行业的淡季；今年，PCB行业的一季度业绩相当炸裂。

据记者初步梳理，截至4月19日，已有10多家PCB产业链公司披露了今年一季度业绩情况（包括一季报和业绩预告）。其中，增速最迅猛的是天津普林。一季度，公司实现营收4.24亿元，同比增长42.39%；实现归母净利润1159.14万元，同比增长2187.33%。相较于去年一季度业绩基数较小的天



津普林，PCB行业龙头东山精密更具代表性。东山精密预计，一季度，公司实现归母净利润10亿元至11.5亿元，同比增长119.36%至152.27%。需要提及的是，东山精密一季度业绩还受益于光模块业务的增长。

从业绩变动原因看，PCB行业本轮增长主要来自需求扩张，体现为产品结构与产业链的同步升级。

另一家龙头企业沪电股份表示，高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景带动印制电路板需求结构变化，公司中高阶产品与量产技术优势得到体现。广合科技表示，公司围绕AI服务器、交换产品及加速卡等算力PCB市场，以技术创新驱动产品结构优化。

这一趋势在向上游加快传导。今年一季度，PCB上游材料与设备企业的整体增速，甚至还要高于PCB制造环节。

比如：PCB钻针棒材供应商欧科亿预计，公司一季度归母净利润为1.8亿元至2.2亿元，同比增长2248.89%至2770.86%；电解铜箔供应商嘉元科技预计，一季度归母净利润同比增长329.33%至394.76%；鼎泰高科一季度归母净利润同比增长259%；大族数控一季度营收同比增长103.69%，归母净利润同比增长176.53%；芯碁微装预计，一季度归母净利润同比增长104.45%至138.53%；光华科技一季度净利润同比增长63.19%……

在PCB行业带动下，上游一季度业绩出现井喷的同时，PCB在AI算力需求带动下，也向高多层、高频高速等方向升级，并对上游材料、设备提出更高的性能要求，推动产业链的科技含量进一步提升。

供不应求 高端产品景气度拉长

业绩增长能否持续，或者还能持续多久？记者采访了解到，业内已基本达成共

识——需求旺盛，高景气度可以贯穿2026年全年，高端产品甚至到2027年都可能供不应求。

景气度攀升的最直观表现就是涨价。今年以来，南亚新材、建滔积层板、台光电等覆铜板厂商均上调覆铜板价格，涨幅为5%至15%。此外，电子布价格也在持续上涨。

价格上涨的背后，是供需关系趋紧。“近来，覆铜板、电子布的价格每个月环比上涨十几个百分点，预计未来仍将延续涨势。”某覆铜板上市公司相关负责人表示，目前覆铜板、电子布的平均交期已从此前的7天延长到15天至20天。

从供给端看，在产能有限的情况下，材料供应商更倾向于优先保障工艺复杂、毛利率更高的高端PCB订单，产业链出现了一定程度的“虹吸效应”，进一步加剧结构性紧张。“同时，部分中低端订单开始‘溢出’至其他产能渠道，整体供应链趋紧。”上述负责人说。

这一变化也传导至PCB制造环节。科翔股份董事长郑晓蓉向记者透露，高端PCB产品交期已由30天延长至90天，中低端PCB产品交期也由25天延长至35天。

旺盛的下游需求体现在订单能见度上。胜宏科技近期披露的投资者关系活动记录显示，公司PCB行业订单能见度通常为2个月左右，高端产品订单能见度更长。对比来看，2023年6月，胜宏科技公告的订单能见度为约1个月。

基于此，PCB厂商普遍提前备料并压缩库存。郑晓蓉表示，高端PCB需提前约2个月进行原材料备料，库存水平处于历史低位。同时，供需趋紧叠加成本上行，推动PCB产品价格整体抬升，高端PCB涨价幅度明显，“高端PCB产品涨价幅度达50%至60%，中低端PCB产品涨价幅度为20%至30%”。

纷纷扩产 行业高低端分化将加剧

一季度以来，已有多家PCB行业龙头企业宣布扩产事宜。

3月13日，胜宏科技抛出200亿元的年度投资计划，投资方向涵盖新厂房建设、生产设备的采购以及自动化生产线的技术改造等。4月21日，公司将登陆港交所，募资净额约为172.87亿港元，其中74%拟用于扩产。

无独有偶。沪电股份年内已四次公告宣布扩产，总投资额约为177亿元，聚焦于高阶PCB产能；鹏鼎控股在今年3月公告，全资子公司庆鼎精密拟在淮安投资110亿元建设高端PCB项目生产基地；科翔股份公开表示，公司正在建设年产10万平方米的高端服务器用PCB募投项目，将为公司带来高端服务器产能。

密集扩产的动作，可以视为其在AI算力需求增长背景下的“卡位”战略。长期来看，AI算力基础设施的迭代升级将推动PCB行业持续增长。灼识咨询数据预测，AI服务器PCB在2024年至2029年的复合年增长率将达20.8%。

“未来，先进技术和量产能力将是PCB供应商角逐海外大厂供货商名额的决定性因素。”某PCB设备厂商董事长表示。

然而，本轮PCB扩产潮似乎是“头部玩家”的竞赛场，中小厂商尚未在扩产方面进行跟进。

沪电股份的一名负责人告诉记者，以AI服务器、数据中心、高性能计算为代表的PCB市场需求快速增长，技术壁垒持续提升，传统PCB市场则逐步进入竞争加剧、价格压力上升的“红海”阶段。“这种需求结构的分化，正在加速行业的优胜劣汰与价值重构。”该负责人说。

中国移动一季度营收微增 两大央企股东“携手”增持

记者 王子霖

中国移动4月20日晚披露的一季报显示，公司一季度营业收入为2665亿元，同比增长1.0%。其中，主营业务收入为2199亿元，同比下降1.1%；其他业务收入为466亿元，同比增长12.7%。

一季度，中国移动实现归属于母公司股东的净利润293亿元，同比下降4.2%，归属于母公司股东的净利润率为11.0%。EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为767亿元，同比下降5.0%，EBITDA占主营业务收入比为34.9%。

中国移动一季度利润表现承压，与电信服务增值政策调整相关。根据此前三大运营商发布的公告，自2026年起，境内通过固网、移动网、卫星及互联网提供手机流量、短信彩信、互联网宽带接入等服务的业务活动，其适用税目由“增值电信服务”调整为“基础电信服务”，对应增值税税率由6%上调至9%。

记者注意到，截至一季度末中国移动的股东榜单中，出现了两位“新面孔”——一汽股权投资（天津）有限公司与中国能源建设集团有限公司。其中，一汽股权投资（天津）有限公司持股数量为1388.63万股，以0.06%的持股比例位列东榜第九，中国能源建设集团有限公司以1302.50万股位列东榜第十。

目前，中国移动的前十大股东列表里还有中国石油天然气集团有限公司、国家能源集团资本控股有限公司和中国网英大国际控股集团有限公司，三家央企分别位列东榜第四、第五和第七。值得一提的是，险资也在今年一季度选择了加仓。“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪”期内增持360.43万股，目前位列东榜第六。

进入2026年，中国移动在人工智能领域已有较大动作。年初，中国移动实施了两项重要组织架构调整：一是在集团层面单独设立算力专项办公室；二是将原“数智化部”整体改组为“数智事业部”。人事变动方面，徐海勇今年3月成为中移九天人工智能科技（北京）有限公司的新任负责人。

根据中国移动此前公布的数字，2026年公司计划资本开支1366亿元，其中算力和智能网络资本开支将显著提升，分别增长62.4%、19.8%。三大网络中，算力和智能网络投资占比超37%。

中国移动在一季报中表示，公司将持续做强做优做大通信、算力、智能服务，着力提质增效、提升核心竞争力，着力推进科技创新、发展新质生产力，推动实现质的有效提升和量的合理增长，向“世界一流科技服务企业”迈出坚实步伐，持续为广大股东、客户创造更大价值。

万华化学 首季净利润同比增逾两成

记者 王玉晴

4月20日晚，万华化学披露2026年一季度报：当季实现营业收入540.52亿元，同比增长25.50%；实现归属于上市公司股东的净利润37.18亿元，同比增长20.62%。公司同日发布的2025年年报显示，公司2025年营收增长11.62%，归属于上市公司股东的净利润下降3.88%。公司同步披露高达39亿元的年度分红计划。

万华化学分析，一季度，公司围绕“提质增效年”的工作部署，应对全球经贸秩序的深刻变化。一季度乙烯一期装置原料多元化改造优势凸显，3月受国际原油价格上涨、全球化工产业供需格局改变等因素影响，公司主要产品价格同比上涨，毛利增加。

年报显示：2025年，公司实现营业收入2032.35亿元，同比增长11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润125.27亿元，同比下降3.88%。公司表示，2025年全球经济情况日益复杂，化工行业在深度调整中呈现分化复苏态势。公司立足“变革年”主题，紧抓“化工+新能源”的转型关键抓手，坚持以技术创新驱动产业升级，持续优化全球生产基地与供应链布局。此外，积极投入新能源行业，重点开拓海外新兴市场区域。

万华化学特别提到第二主业主电池材料产业的进展。2025年，公司对电池材料持续开展压强式研发投入。磷酸铁锂实现四代产品量产并导入客户，五代产品获头部客户认可且关键指标领先，竞争力大幅提升。钠电实现三代产品定型及产业化，完成客户端验证，性能领先。连续石墨化完成高端低耗储能产品开发，硅碳负极产品实现销量突破，性能得到市场认可。

股东回报方面，万华化学2025年度拟每股派发现金红利1.25元（含税），合计派发现金红利高达39.13亿元。现金分红加当年回购并注销金额合计44.13亿元，占年度归属于上市公司股东净利润的35.23%。截至2025年底，公司累计现金分红总额已达502亿元。

展望2026年，万华化学称，将继续聚焦关键核心技术攻关，在巩固聚氨酯、石化等现有领域优势的同时，依托顶尖人才与研发平台，聚焦新能源、新材料、营养健康等研发方向，攻坚新一代磷酸铁锂开发与产业化，推动高端聚烯烃技术迭代，探索“AI+材料研发”新模式，加速成果转化，以技术突破打造产业新优势。

董事长专访

“专精”先进封装 盛合晶微筑牢AI算力封测基座



盛合晶微董事长 王新军

记者 李兴彩

随着摩尔定律逼近物理极限，先进封装成为延续芯片性能增长、支撑AI算力爆发的核心赛道，产业战略地位空前提升。早在12年前，盛合晶微就前瞻研判到先进封装产业趋势，深耕中段凸块（Bumping）制造，并一路发展至登峰造极。

“盛合晶微成立12年来始终坚守初心，公司起步于中段凸块加工，并在此基础上延伸至2.5D封装，接下来将发力超高密度互联芯片封装集成封装等3D IC先进封装服务。”日前，盛合晶微董事长王新军接受上海证券报记者专访，简洁明了地介绍了公司业务。

盛合晶微是国内最早实现12英寸凸块制造量产的企业之一，也是国内第一家提供14纳米先进制程凸块制造服务的企业。据Gartner的统计：2024年度，公司是全球第十六、国内第四大封装企业；公司12英寸WLCSP（晶圆级封装）、2.5D封装收入规模均稳居国内第一。

从中段凸块到2.5D先进封装 全面行业领先

2015年初，记者在时任长电科技董事长

王新军的办公室见到崔东时，他就介绍了盛合晶微主营中段凸块加工。彼时，盛合晶微刚刚成立，短短10多年，公司已成为国内第四大封装公司。

“盛合晶微聚焦12英寸中段凸块加工，当时国内需求还寥寥无几，但海外需求趋势已经确立。”回忆起创业缘起，崔东表示，公司创立之初便锚定“超越摩尔定律”的异构集成方向，这也使得公司起步就是国际化团队和市场运作机制，而前期每一个新工艺平台推出，首先服务的也是国际头部公司，率先进入一流企业供应链。

高举高打之下，盛合晶微在中段凸块领域迅速“异军突起”，成为国内最早实现12英寸凸块制造量产的企业之一，也是国内第一家提供14纳米先进制程凸块制造服务的企业。2024年，公司12英寸凸块产能位居国内第一，市占率超过25%。

“间距不同，凸块技术的规格和工艺平台就不可相提并论。”崔东介绍，从100微米间距到40微米，都属于凸块制造的技术范畴，但应用领域不一样，盛合晶微的凸块最小间距可以达到20微米，可支撑最先进制程芯片的各式先进封装制造需求。

正是在凸块技术深厚积累基础上，盛合晶微顺利将业务延伸到2.5D先进封装。

“不管是凸块制造，还是2.5D封装，盛合晶微都做到了全球领先、国内第一。”崔东介绍，公司的2.5D技术平台涵盖硅通孔转接板（硅转接板）、扇出型重布线层（有机转接板）和嵌入式硅桥（硅桥转接板）等各类主流技术方案，并已形成全流程2.5D的技术体系和量产能力，是国内在硅粒多芯片集成封装领域起步最早、技术最先进、生产规模最大、布局最完善的企业之一，并具备在上述领域追赶全球最领先企业的能力。

公开资料显示，盛合晶微作为国内唯一实现硅基2.5D大规模量产的企业。2024年，公司是国内12英寸WLCSP收入规模和

2.5D收入规模均排名第一的企业，公司的2.5D封装国内市占率高达85%，全球市占率约为8%。

先进封装成产业新高地 获明星股东力捧

4月15日，盛合晶微发布科创板IPO发行结果公告，获得公司战略配售的包括海光信息、中微公司、天数智芯、沐曦股份（子公司沐曦智芯）、聚辰股份、华虹宏力等13家半导体公司，以及中金财富、公司员工持股平台公司。

盛合晶微IPO引发投资者强烈申购意愿，初步询价阶段共有305家网下投资者参与报价，涵盖公募基金、私募基金、券商资管等全类型机构。

精准卡位先进封装，让盛合晶微成为一级市场的“香饽饽”。招股书显示，公司股东阵容强大，不仅囊括中金系、招银系、元禾璞华、中芯聚源等头部金融机构和PE，也汇聚了无锡产发基金、孚腾芯飞等国资力量。

资本追捧的背后，是先进封装在AI算力时代站上产业新高地。

“随着AI算力持续高速增长，先进封装也站上产业链主舞台，成为一个坡长雪厚的赛道。”对于盛合晶微备受产业界追捧，有半导体业内人士解读称，面对摩尔定律放缓、单芯片算力开发难度和成本急剧提升，芯粒（Chiplet）异构集成成为提升算力、降低成本的最优解，而2.5D/3D封装是芯粒落地的核心载体。

产业方面，由于AI对大算力芯片、HBM需求持续强劲，2.5D/3D先进封装产能持续紧缺，供不应求局面将延续至2027年下半年。主流机构预计，到2030年全球先进封装市场规模将达到800亿美元，2025年至2030年的复合年均增长率为9.4%。

上述业内人士表示，在此产业背景下，盛合晶微作为国内稀缺的具备规模化2.5D/3D

封装能力的企业，直接绑定AI算力芯片产业链，既是国产算力自主可控的关键环节，也是资本布局先进封装赛道的首选标的。

持续“专精”主业 募资50亿元加码3D IC

当前，盛合晶微主营业务已经形成中段凸块加工、晶圆级封装、芯粒多芯片集成封装等三大类，且芯粒多芯片集成封装逐渐成为主力业务，2025年上半年营收占比升至56.24%。

与此同时，盛合晶微的营收和利润也实现了快速增长。公司2022年至2025年分别实现营业收入16.33亿元、30.38亿元、47.05亿元和65.21亿元，实现归母净利润-3.29亿元、3413.06万元、2.14亿元和9.23亿元。其快速增长的业绩反映出强劲的增长势头和发展韧性。

上市新起点，盛合晶微未来的发展战略又是怎样的？

“一流、补链、专精特新。”崔东的回答简洁果敢：盛合晶微将不忘初心，致力于成为全球领先的芯粒多芯片集成封装企业；在后摩尔时代与客户紧密协同，大力投资研发、推动技术进步，满足高算力、高带宽、低功耗等全面性能提升对先进封装的综合性需求。

芯粒多芯片集成封装即把多颗芯粒或元器件组合到单个芯片系统中，主要包括2.5D硅载板级集成技术、多芯片组集（MCM）等基板级技术方案，以及三维芯片集成（3D IC）、三维封装（3D Package）等晶圆级技术方案。“公司下一步将重点发力3D IC三维集成业务。”崔东透露，由于持续增长的芯片算力需求和混合键合技术的进步，先进封装产业正加速向3D IC演进。

招股书显示，盛合晶微本次募资约50亿元，全部投向芯粒多芯片集成封装领域，包括三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目等两大募投项目。